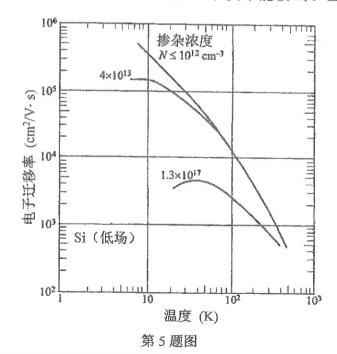
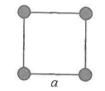
科目代码: 823 科目名称: 半导体物理

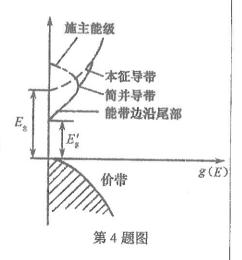
## ★所有答案必须做在答题纸上,做在试题纸上无效

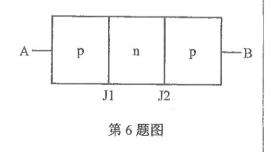
- 一、简答题(共49分,每题7分)
- 1. 右方题图中给出了简立方结构晶胞在 [100] 面上的投影图。参照这个例子,画出面心立方和金刚石结构晶胞在 [100] 面上的投影。
- 2. 分别按禁带宽度  $E_g$  和本征载流子浓度  $n_i$  的大小给 Si、Ge、GaAs 三种半导体排序。
- 3. 示意性地画出 As、Al 和 Au 杂质能级在 Si 禁带中的位置。
- 4. 右方题图中显示的是什么效应?请给出简要解释。
- 5. 简要解释下方题图所示的载流子迁移率变化规律。
- 6. 画出右下方题图所示的结构在热平衡下的能带图, 包含导带底  $E_{\rm C}$ 、价带顶  $E_{\rm V}$  和费米能级  $E_{\rm F}$ 。当电极





简立方晶胞在[100]面上的投影(a为晶格常数)第1题图

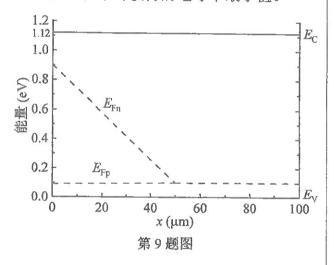




科目代码: 823

科目名称: 半导体物理

- 7. 右方题图中给出了一个肖特基二极管结构。在(1)、(2)两个位置处,哪个是肖特基接触,哪个是欧姆接触?为什么?
- 二、综合分析和计算题(共101分)
- 8. (12 分) 在温度为 300 K 的热平衡条件下:
  - (1) 计算 p 型掺杂浓度  $N_A = 1 \times 10^{13}$  cm<sup>-3</sup> 的 Si 样品中多子、少子浓度和电导率  $\sigma$ ; (计算所需参数查试题附件 1, 下同)
  - (2) 随着掺杂浓度持续降低,样品将趋向于本征半导体,电导率将持续下降,试推导和计算在降低掺杂浓度过程中可获得的电导率最小值。
- 9. (18分) 一个 100 μm 长的 Si 样品,在 300 K 和稳态下的能带图如题图所示。(1) 该样品是 p 型还是 n 型? 是均匀还是非均匀掺杂? 是处于热平衡还是非均匀掺杂? 是处于热入了。(2) 计算样品的掺杂浓度,以及热平衡下价带顶不被电子占据的几率(采用玻尔兹曼近似,计算所需参数查附件 1);(3)以 x 轴方向为正方向,推算电子在 x = 0 处的扩散电流密度 idm (必要时查附件 2)。



金属

n

 $n^{+}$ 

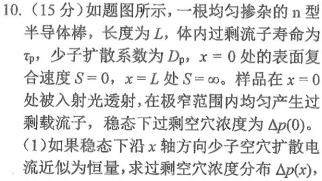
金属

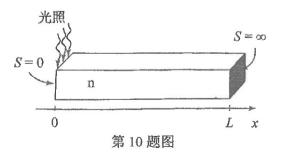
阴极K

第7题图

(1)

(2)





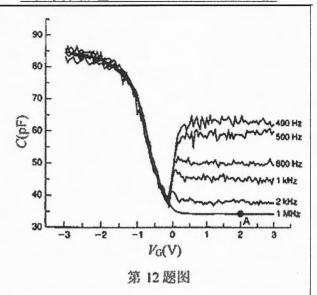
以及长度 L 所需满足的条件; (2) 光照停止后,过剩载流子将很快因复合而消失,请简述半导体体内可能发生的两种复合过程。

试题2022年

#### 北京工业大学 2022 年全国硕士研究生招生考试试题

科目代码: 823 科目名称: 半导体物理

- 11.(20分)300 K 下一个两侧均匀掺杂的 突变 pn结,p侧掺杂浓度  $N_A = 10^{18}$  cm<sup>-3</sup>,接触电势差  $V_D = 0.75$  V:(1)计算 n侧掺杂浓度  $N_D$ ;(2)计算反偏 100 V 下单位面积势垒电容  $C_T$ ;(3)该 pn结的击穿电压随温度提高如何变化?要提高击穿电压,n 侧掺杂浓度应如何变化?为什么?
- 12.(24 分)一个由金属/SiO<sub>2</sub>/Si 构成的 MOS 电容 *C-V* 特性的实测结果如题图 所示, 电容面积为 0.12 mm<sup>2</sup>:(1)图中点 A 处衬底表面处于什么状态? 画出此时的电荷分布图和能带图;(2)估算



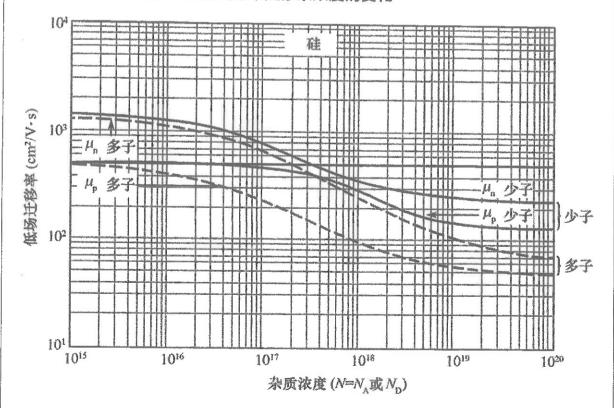
氧化层厚度  $d_0$  和最大耗尽区厚度  $x_{dm}$ ; (3)根据试题附件 3、4 所附图表估算衬底的掺杂浓度 N、平带电容  $C_{FB}$  和平带电压  $V_{FB}$ ; (4)计算该 MOS 结构的阈值电压  $V_{To}$ 。

13. (12 分)利用霍尔效应或热探针实验可以检测半导体样品的导电类型。请分别简述这两种方法的原理并给出必要的图示。

科目代码: 823 科目名称: 半导体物理

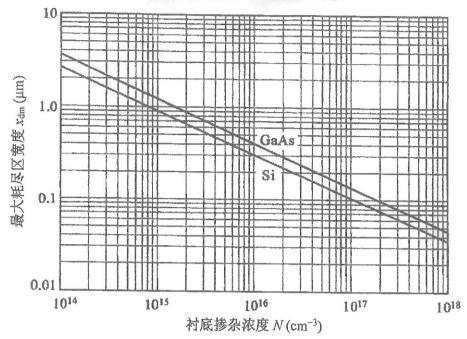
#### 附件 1 一些常用的参数 (300 K下) 电子电荷 $1.6 \times 10^{-19} \,\mathrm{C}$ q波尔兹曼常数 k $1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 电子伏特 eV $1.6 \times 10^{-19} \,\mathrm{J}$ 二氧化硅相对介电常数eox 3.9 真空介电常数 $8.85 \times 10^{-14} \text{ F/cm}$ Si 材料的性质 本征载流子浓度 $1.5 \times 10^{10} \, \mathrm{cm}^{-3}$ $n_{\rm i}$ 导带底等效状态密度 NC $2.8 \times 10^{19} \, \mathrm{cm}^{-3}$ 价带顶等效状态密度 Nv $1.1 \times 10^{19} \, \text{cm}^{-3}$ 相对介电常数 ESi. 11.9 电子迁移率 1400 cm<sup>2</sup>/V·s $\mu_{\rm n}$ 空穴迁移率 $500 \text{ cm}^2/\text{V} \cdot \text{s}$ $\mu_{\rm p}$

#### 附件 2 硅中多子和少子低场迁移率随掺杂浓度的变化



科目代码: 823 科目名称: 半导体物理

附件 3 MOS 结构衬底掺杂浓度与最大耗尽区宽度的关系



附件 4 硅 MOS 结构归一化平带电容与氧化层厚度关系

